

エコソルダボールに最適なボールアタッチ用フラックス

High quality ball attachment flux for semiconductors

デルタラックス 901シリーズ ~無洗浄低残渣タイプFC接続用フラックス~

残渣が少ない、転写・スプレー用フラックス

特長

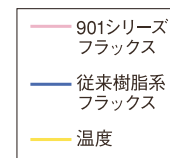
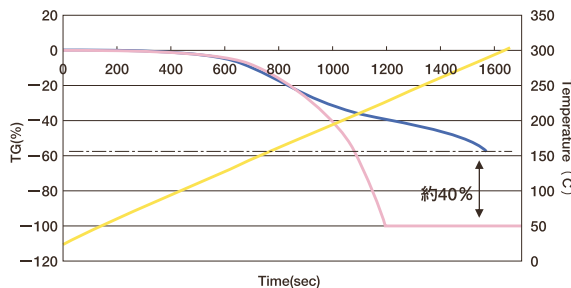
- リフロー後の残渣が少ない。
- 洗浄無しでアンダーフィル注入が可能。
- 転写用901K3、スプレー用901E7をラインナップ



製品仕様

□ 残渣の熱重量測定

901シリーズは従来の樹脂系フラックスに比べ残渣が40%以上減少しました。



デルタラックスGTN-68 ~濡れ性向上タイプ樹脂系フラックス~

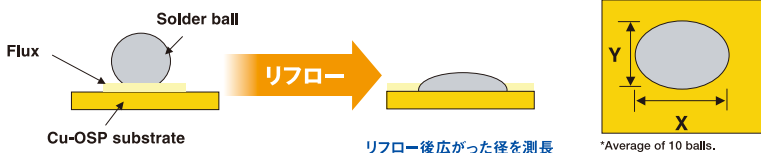
環境に配慮した活性力の強いフラックスの開発で濡れ性を向上

特長

- 様々な実装条件に適用が可能
- 活性力の強いフラックスで、OSP膜の除去が可能

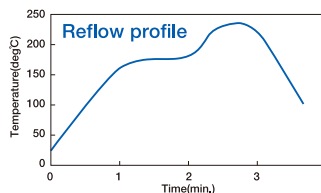
製品仕様

□ Cu-OSP広がり試験



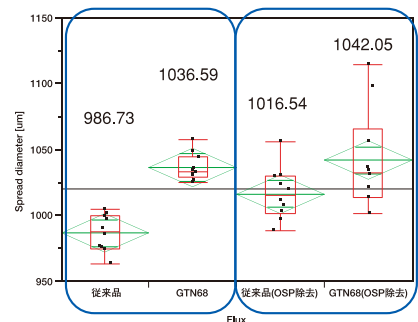
広がり試験用フラックス

- デルタラックス 529T : ハロゲン量 0.2 %
- デルタラックス GTN-68 : ハロゲン量 0.2 %
- フラックス厚 0.12 mm
- ハンダボール SAC305 φ0.5 mm
- 洗浄液 東ソー HC-FX-50



□ Cu-OSP広がり試験結果

試験1 Cu-OSP上で各フラックスによる広がり試験 試験3 OSP除去フラックス使用、洗浄後広がり試験



従来フラックス(529T)に比べてGTN-68はOSP膜の影響を受けにくく、OSP膜除去後の広がり率と大差ありません。